

臻鼎 2025 年上半年營收創高、獲利回升，2026 年四大應用預期全面加速成長

全球 PCB 領導大廠臻鼎科技控股股份有限公司(股票代號:4958)今(12)日召開法說會，公佈 2025 年第二季暨上半年合併財務報告。第二季營收為新台幣 382.03 億元，年增 17.9%，創下歷年同期新高，稅後淨利為新台幣 13.87 億元，歸屬母公司淨利為新台幣 6.05 億元，每股盈餘為新台幣 0.63 元。2025 年上半年營收為新台幣 782.85 億元，年增 20.6%，亦創下歷年同期新高，稅後淨利為新台幣 24.13 億元，年增 14.7%，歸屬母公司淨利為新台幣 12.37 億元，每股盈餘為新台幣 1.30 元。

董事長沈慶芳表示，今年上半年月營收連續六個月創下歷年同期新高，四大應用領域包含行動通訊、電腦消費、伺服器/車載/光通訊以及 IC 載板皆締造年增表現，其中以 IC 載板年增幅度最高，符合公司先前預期。在產能利用率提升與營運費用控制得宜下，即便上半年折舊及攤銷較去年同期增加新台幣 6.78 億，上半年毛利率仍較去年同期提高 1.7 個百分點至 16.5%，營業利益率較去年同期回升 4.3 個百分點至 4.4%，營運效率持續優化。業外部分，今年上半年匯兌損失為新台幣 6.39 億，相較去年上半年匯兌利益 11.95 億，兩者相差 18.34 億，縱然有匯兌因素干擾，臻鼎稅後淨利仍達到新台幣 24.13 億元，年增 14.7%，經營成果保持穩健。

展望未來，沈董事長表示，下半年客戶新品備貨節奏正常，下半年營運表現將優於上半年，同時，若以美元計價，2025 年全年營收增速保持優於產業平均水準。此外，2026 年將是臻鼎成長關鍵年，不僅在 AI 手機、折疊機與 AI 眼鏡將有明顯成長機會，加上高階 AI 伺服器取得重要客戶訂單、IC 載板需求升溫，預期四大應用營收將全面加速成長。

沈董事長強調，AI 所驅動的高階性能要求與產品創新浪潮仍將是 PCB 產業未來數年的核心成長動能。因應高階 AI 伺服器技術快速演進，臻鼎是少數能夠提供客戶 OAM/UBB 技術整合方案的廠商。公司在 MSAP、HDI 及 HLC 等領域擁有成熟技術與量產實績，並可配合客戶前瞻設計需求，結合高階載板技術及對半導體產業趨勢的了解，與客戶共同開發未來世代高階產品。臻鼎過去幾年在 AI 伺服器累積的技術實力以及對於關鍵製程的掌握已受到重要客戶認可，不僅同步布局 GPU 與 ASIC 平台，更策略聚焦 Advanced HDI 與 HLC 產品，新客戶與新訂單貢獻會在明年開始放大，未來 AI 伺服器營收佔比將逐步提升。

在 IC 載板方面，沈董事長指出，臻鼎繼去年營收締造逾 75% 的高成長動能後，2025 年上半年仍繳出近 35% 年增幅度。隨著產業供需結構逐步改善，公司預期今年 IC 載板仍將是臻鼎四大產品應用中成長最快的業務部門，全年營收成長目標超過四成。ABF 載板方面，來自 AI 資料中心應用的客戶打樣需求明顯增加。臻鼎已具備高階應用所需的技術能力(尺寸超過 120mm、層數達 26 至 28 層)，可滿足客戶對先進 ABF 載板的要求。BT 載板方面，邊緣 AI 的產品升級帶動高階 BT 載板需求提升，目前產能利用率達 90%，營收穩健成長。

因應客戶對高階 AI 產品的未來訂單需求明顯成長，沈董事長表示，臻鼎規劃提高今、明兩年的資本支出金額至新台幣 300 億以上，其中近 50% 資本支出將用於擴大高階 HDI 和 HLC 產能，以

掌握相關產品成長契機。以全球產能布局而言，今年大陸廠區將擴建 AI 產品用高階 HDI、HLC 產能，以及去瓶頸高階軟板產能。泰國一廠自 5/8 試產以來，已有伺服器及光通訊領域重要客戶通過認證，預期 4Q25 將進入小量產；泰國二廠亦積極建設中。另外高雄 AI 園區之高階 ABF 載板與 HLC+HDI 產能陸續裝機，將於年底進入試產。隨著泰國與高雄兩大基地的生產效益於明、後年起陸續顯現，公司正向看待未來營運表現。

單位：新台幣百萬元，除每股盈餘外

期間	1H25	1H24	年變動
營業收入	78,285	64,922	+20.6%
營業毛利	12,896	9,584	+34.6%
營業利益	3,481	99	3,415.1%
稅後淨利	2,413	2,103	+14.7%
歸屬母公司淨利	1,237	1,463	-15.4%
每股盈餘	1.30	1.55	-16.13%
毛利率	16.5%	14.8%	+1.7ppts
營業淨利率	4.4%	0.2%	+4.3ppts
純益率	3.1%	3.2%	-0.1ppts

詳細財報相關資訊請至公司網站「[投資人專區](#)」查詢。

關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、高多層及高密度印刷電路板(HLC-HDI)、多層硬板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據 Prismark 以營收計算的全球 PCB 企業排名，臻鼎 2017 年至 2024 年連續八年榮登全球最大 PCB 生產企業，更多詳細資訊請至公司網站: www.zdtco.com。

公司發言人

凌 惇

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: duen.t.ling@zdtco.com